

ともに歩む、その先の革新へ



イビデン株式会社

2026年3月期(2025年度) 通期決算説明会

2026年5月12日(火)

イベント概要

[企業名] イビデン株式会社

[証券コード] 4062

[イベント言語] JPN

[イベント種類] 決算説明会

[イベント名] 2026年3月期 通期決算説明会

[開催日] 2026年5月12日(火)

[開催時間] 9:45～10:45 (合計1時間：説明20分、質疑応答40分)

[開催場所] インターネット配信

[登壇者] 3名

代表取締役社長	河島 浩二
経営役員 経営企画本部長	宮崎 信治
幹部職 経営企画部長	廣瀬 康人

2026年3月期 通期決算説明会 主な質疑応答

<質問者 1>

- [Q] 今回アップデートされた中期業績見通しにおいて、営業利益率が従前の見方よりもかなり高くなっているが、その背景について具体的に教えてほしい。
- [A] 利益率の上昇については、中間時点(10/31)よりも AI 関連需要が想定以上に強くなっており、これに伴い高付加価値製品の出荷比率が上昇したことが利益率の上方修正につながっている。
- [Q] 2030年度の売上・営業利益計画を上方修正したが、中間時点(10/31)と比べて達成の確度は増したか？
- [A] 今回開示した計画については、5,000億円の投資をしっかりとやりきれば達成できると考える。
- [Q] 今後更なる設備投資を行う予定はあるか？
- [A] 最先端 IC パッケージ基板に対する市場のデマンドは非常に強く、更なるキャパシティの拡大も求められる。人的リソースや時間の問題もあり、2028年度までは今の計画以上にキャパシティを増やすのは難しいと考えるが、我々としてはベストを尽くしたい。

<質問者 2>

- [Q] IC パッケージ基板の今後の価格トレンドについて、収益性を押し上げる可能性があるのか、またキャパシティの制約はどう影響するのか？
- [A] 価格については、製品ミックス良化による価格アップと、売価維持が全体の要素としてある。また、材料費の上昇分についても顧客と合意の上で価格転嫁できている。ただし、当社としては長期的なお客様との関係を重視する方針のため、リーズナブルな範囲で価格交渉を行う。
- [Q] 説明会資料 p15 のロードマップにおいて、基板の製造難易度が増していく中で、競争環境はどのように変化していくと想定するか？
- [A] インターポーザー型についての競争環境は大きく変わらないと考えている。世代交代によって、新世代製品が立上がったタイミングは 100%に近いシェアを獲得し、3ヶ月～半年ほど経つとシェアが2割から3割程度落ちることが想定される。
一方、シリコンブリッジ型については、シリコンブリッジの裏側の接続難易度がかなり高く、少なくとも 2030 年までは技術的な優位性を維持できると考える。

<質問者 3>

- [Q] 5,000億の設備投資金額はどのように手当てするのか？
- [A] 基本的には顧客と契約を締結して投資相当額を負担いただき、一部は前払いで受領する。追加の資金調達については、現時点では考えていない。

<質問者 4>

[Q] 説明会資料 p8 について、スイッチ向け IC パッケージ基板が増加している背景について教えて欲しい。

[A] スイッチ向け IC パッケージ基板については、2025 年度から量産的なサポートを開始している。GPU 向けや ASIC 向けと同様に大型化・高多層化が進んでおり、今後サーバーの高速化などを考えると非常に重要な位置付けになると予測している。まずは昨年度の下期から取引が始まったお客様をサポートしていく。また、大手 GPU 顧客からもスイッチ用基板の受注があり、スイッチ向け IC パッケージ基板の売上は今後拡大していく見込み。

以上